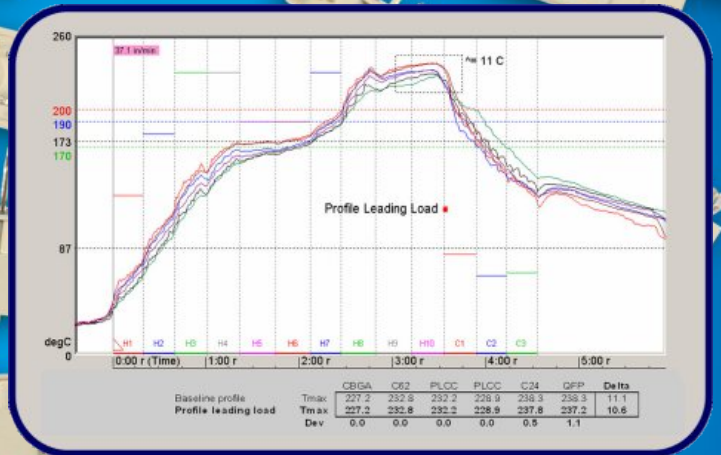
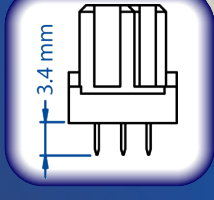
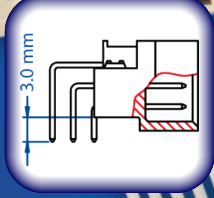
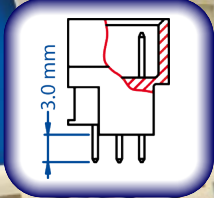
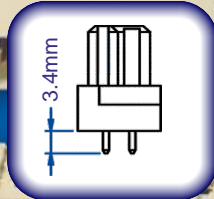
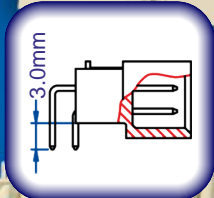
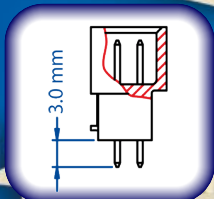
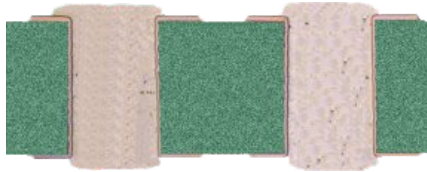


HI-CON®

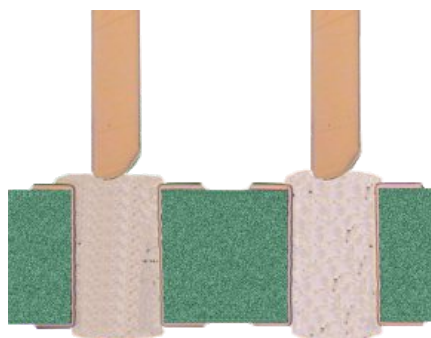


- Beim Einsatz von Steckverbindern auf mischbestückten Leiterplatten entstand bisher der Nachteil, dass der THR-Prozess nicht durchgängig automatisierbar war und so höhere Kosten verursachte. Abhilfe schaffen hier Steckverbinder in THR (Through Hole Reflow). Diese eignen sich für ein kostengünstiges und schnelles Bestücken und Löten mit gleichzeitig verwendeten SMD Bauteilen.
- Weitere Fertigungsschritte wie selektives Löten oder Einpressen können dann entfallen. Das Verfahren ist auch unter dem Namen „Pin in Paste“ bekannt (PIP).
- Bislang mussten zunächst die SMT-Bauteile bestückt und danach reflowgelötet werden, bevor man in einem zusätzlichen Arbeitsschritt die Steckverbinder auf der Baugruppe einpressen konnte. Jetzt werden die Messer- und Federleisten vollautomatisch mit anderen Bauteilen im SMD-Prozess verlötet.
- Pancon Steckverbinder in THR bestehen aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff, der die Anforderungen der J-STD-020D (Anforderungen an gelötete elektrische und elektronische Baugruppen) erfüllt. Sie sind für das Reflow-Löten mit bleifreien Loten und Temperaturspitzen bis zu 260°C geeignet.

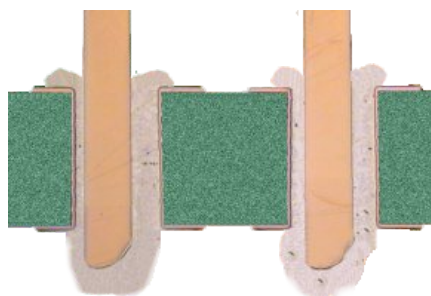
Leiterplatte, Bohrungen sind mit Lotpaste gefüllt



Die Steckverbinder werden eingedrückt



Bereit für den Reflow-Prozess



THR (Through Hole Reflow)

umschreibt fertigungstechnisch dabei folgende Vorgehensweise:

- Der Prozess beginnt mit dem Aufbringen der Lotpaste auf die Leiterplatte. Dies geschieht entweder mittels Siebdruck, Dispenser oder durch Lotformteile (Preforms).
- Jetzt erfolgt das Aufsetzen der SMD Bauteile auf die Platine. Anschließend werden die Steckverbinder in die mit Paste gefüllten Bohrungen eingesetzt.
- Für das Reflow-Löten ist eine homogene Wärmeverteilung und damit ein ungehinderter Zugang der Konventionwärme zu allen Lötstellen erforderlich.
- Obwohl die Steckverbinder ein größeres Volumen als die übrigen SMT-Bauteile haben, benötigen Sie keine längere Lötzeit. In puncto Festigkeit und Langzeit-Zuverlässigkeit unterscheiden sich die THR-Lötverbindungen nicht von konventionellen Lötstellen. Auch visuelle Anforderungen internationaler Standards werden erfüllt.

- DIN Steckverbinder werden in verschiedensten Umgebungen mit unterschiedlichen Befestigungsverfahren eingesetzt. Neben vielen Varianten für das Reflow-Verfahren sind diese auch wie gewohnt in Einpresstechnik oder für weitere Lötverfahren bei Pancon erhältlich.

1	120131	Logo changed	rok
REV	DATE	NOTE	NAME

Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice in Bezug auf Preis und Verfügbarkeit

Pancon P/N	style	Description
100-064-033	B	DIN header, Type B, angled, solder pin 3.0mm, 64 contacts, class 2
100-064-133	B	DIN header, Type B, straight, solder pin 3.0mm, 64 contacts, class 2
100-064-432	B	DIN socket, Type B, straight, solder pin 4.6mm, 64 contacts, class 2
100-064-433	B	DIN socket, Type B, straight, solder pin 3.4mm, 64 contacts, class 2
100-096-033	C	DIN header, Type C, angled, solder pin 3.0mm, 96 contacts, class 2
100-096-033B	C	DIN header, Type C, angled, solder pin 3.0mm, 96 contacts, class 2, Clip
100-096-133	C	DIN header, Type C, straight, solder pin 3.0mm, 96 contacts, class 2
100-096-432	C	DIN socket, Type C, straight, solder pin 4.6mm, 96 contacts, class 2
100-096-433	C	DIN socket, Type C, straight, solder pin 3.4mm, 96 contacts, class 2
100-232-033	B	DIN header, Type B, angled, solder pin 3.0mm, 32 contacts in row a, class 2
100-232-133	B	DIN header, Type B, straight, solder pin 3.0mm, 32 contacts in row a, class 2
100-232-432	B	DIN socket, Type B, straight, solder pin 4.6mm, 32 contacts [row a], class 2
100-232-433	B	DIN socket, Type B, straight, solder pin 3.4mm, 32 contacts [row a], class 2
100-332-033	C/2	DIN header, Type C/2, angled, solder pin 3.0mm, 32 contacts [rows a & c], class 2
100-332-432	C/2	DIN socket, Type C/2, straight, solder pin 4.6mm, 32 contacts [rows a & c], class 2
100-332-433	C/2	DIN socket, Type C/2, straight, solder pin 3.4mm, 32 contacts, class 2
100-348-033	C/2	DIN header, Type C/2, angled, solder pin 3.0mm, 48 contacts, class 2
100-348-133	C/2	DIN header, Type C/2, straight, solder pin 3.0mm, 48 contacts, class 2
100-348-432	C/2	DIN socket, Type C/2, straight, solder pin 4.6mm, 48 contacts, class 2
100-348-433	C/2	DIN socket, Type C/2, straight, solder pin 3.4mm, 48 contacts, class 2
100-532-033	B	DIN header, Type B, angled, solder pin 3.0mm, 32 contacts [rows a & b / even numbers], class 2
100-632-033	B/2	DIN header, Type B/2, angled, solder pin 3.0mm, 32 contacts, class 2
100-632-133	B/2	DIN header, Type B/2, straight, solder pin 3.0mm, 32 contacts, class 2
100-932-033	C	DIN header, Type C, angled, solder pin 3.0mm, 32 contacts [rows a & c, even numbers], class 2
100-932-033B	C	DIN header, Type C, angled, solder pin 3.0mm, 32 contacts [rows a & c, even numbers], class 2, Clip
100-932-133	C	DIN header, Type C, straight, solder pin 3.0mm, 32 contacts [rows a & c, even numbers], class 2
100-964-033	C	DIN header, Type C, angled, solder pin 3.0mm, 64 contacts, class 2
100-964-033B	C	DIN header, Type C, angled, solder pin 3.0mm, 64 contacts, class 2, Clip
100-964-133	C	DIN header, Type C, straight, solder pin 3.0mm, 64 contacts, class 2
100-964-432	C	DIN socket, Type C, straight, solder pin 4.6mm, 64 contacts, class 2
100-964-432B	C	DIN socket, Type C, straight, solder pin 4.6mm, 64 contacts, class 2, Clip
100-964-433	C	DIN socket, Type C, straight, solder pin 3.4mm, 64 contacts, class 2
130-096-133	R	DIN header, inverted [R], class 2, 96 contacts, 4.0mm solder pin
130-096-533	R	DIN socket, inverted [R], class 2, 96 contacts, 3.0mm
130-964-133	R	DIN header, inverted [R], class 2, 64 contacts, 4.0mm
130-964-533	R	DIN socket, inverted [R], class 2, 64 contacts, 3.0mm